

评级：增持（维持）

分析师：王芳

执业证书编号：S0740521120002

Email: wangfang02@zts.com.cn

分析师：杨旭

执业证书编号：S0740521120001

Email: yangxu01@zts.com.cn

分析师：李雪峰

执业证书编号：S0740522080004

Email: lixf05@zts.com.cn

分析师：游凡

执业证书编号：S0740522120002

Email: youfan@zts.com.cn

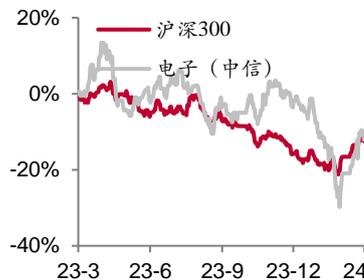
基本状况

上市公司数 463

行业总市值(百万元) 6,228,497

行业流通市值(百万元) 2,989,973

行业-市场走势对比



相关报告

【中泰电子】半导体周跟踪：戴尔 AI 服务器需求强劲，持续看好 AI 赛道机遇

重点公司基本状况

简称	股价 (元)	EPS				PE				PEG (2024E)	评级
		2021	2022A	2023E	2024E	2021	2022A	2023E	2024E		
寒武纪-U	171	-2.1	-3.1	-2.0	-1.3	-83	-55	-85	-128	-	NA
工业富联	25	1.0	1.0	1.2	1.6	25	25	21	16	0.7	买入
华勤技术	77	2.9	3.9	3.7	4.1	27	20	21	19	1.9	买入
德明利	91	1.6	0.8	0.2	2.7	56	108	412	34	0.4	NA
香农芯创	42	0.5	0.7	0.8	1.0	78	56	53	43	2.1	买入

备注：股价为 2024 年 3 月 8 日收盘价，已覆盖公司采用我们预测值，寒武纪/德明利已发 2023 快报，2023E 采用快报数据，其余数据采用 Wind 一致预期

投资要点

■ 市场涨跌互现，半导体指数跌 1.05%

本周（2024/3/4-2024/3/8）市场涨跌互现，沪深 300 指数涨 0.20%，上证综指跌 0.35%，深证成指跌 0.70%，创业板指数跌 0.92%，中信电子跌 0.17%，半导体指数跌 1.05%。其中：封测板块涨 5.1%，其中通富微电（+13.9%）、长电科技（+8.6%）涨幅居前；设备板块涨 1.2%，其中赛腾股份（+19.8%）、天准科技（+8.3%）、联动科技（+6.0%）、长川科技（+5.0%）涨幅居前；材料板块涨 0.40%，其中中华海诚科（+23.8%）、唯特偶（+15.1%）、雅克科技（+11.5%）涨幅靠前；射频板块跌 0.20%，其中卓胜微（+1.2%）、唯捷创新（-7.3%）、慧智微（-0.5%）；设备零部件跌 0.90%，其中富创精密（+4.9%）、英杰电气（+2.1%）、福晶科技（+1.5%）涨幅居前；存储板块跌 1.3%，其中香农芯创（+21.4%）、同有科技（+9.7%）涨幅居前；SoC 板块跌 1.4%，其中炬芯科技（+0.8%），其他主要标的有不同程度回撤；逻辑板块跌 2.4%，其中景嘉微（+14.8%）、寒武纪-U（+0.7%）涨幅靠前；制造板块跌 2.5%，其中晶合集成（-4.5%）、华虹公司（-3.5%）、燕东微（-2.9%）跌幅居前；功率板块跌 2.7%，扬杰科技（+0.6%）、台基股份（+0.4%）实现上涨，跌幅较大的公司主要有东微半导体（-4.8%）、斯达半导体（-4.6%）、华润微（-4.2%）；MCU 板块跌 3.4%，其中中颖电子（-3.8%）、纳思达（-3.8%）、峰昭科技（-3.6%）、中微半导体（-3.6%）跌幅居前；模拟板块跌 3.7%，其中希荻微（+15.8%）涨幅居前，赛微微电（-10.1%）、纳芯微（-8.8%）、思瑞浦（-7.9%）跌幅居前。

本周 Anthropic 重磅发布其第三代 AI 大模型 ——Claude 3 系列模型，该模型在推理、数学、编码、多语言理解和视觉全方面评分超越 GPT-4，树立了新的行业基准。AI 发展持续催化电子相关板块，其中先进封装/HBM 主题涨幅居前，华海诚科、香农芯创、赛腾股份本周涨幅接近 20%，通富微电涨 14%、长电科技涨近 9%。

■ 行业新闻

Claude 3 系列模型发布，全面超越 GPT-4

北京时间 3 月 4 日晚间，Anthropic 重磅发布其第三代 AI 大模型 ——Claude 3 系列模型，包括 Claude 3 Opus、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Haiku。Opus（最智能）：系列模型最强版本，在推理、数学、编码、多语言理解和视觉全方面评分超越 GPT-4，树立了新的行业基准。

海力士计划扩大存储封测产能

据外媒报道，为了巩固 HBM 存储芯片市场上的领先地位，SK 海力士 2024 年计划投资超过 10 亿美元，扩大在韩国的测试和封装能力（主要是 MR-MUF 和 TSV 的投入）。业内人士预测，SK 海力士今年的资本支出总额将达到 105 亿美元。

马斯克：明年全球将从缺芯转为缺电

2 月 29 日，在“博世互联世界 2024”大会上，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克远程接受了博世 CEO 斯特凡·哈同（Stefan Hartung）和董事长马库斯·海恩（Markus Heyn）的采访。马斯克在采访中提到，人工智能会碰到一些限制，例如芯片短缺，然后是供电问题。马斯克表示：“接下来短缺的将是电力。我认为明年，你会看到，没有足够的电力来运行所有的芯片。”

■ 重要公告

长电科技：3 月 5 日，公司发布公告，旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体（上海）有限公司 80% 的股权，收购对价约 6.24 亿美元。本次交易出售方为 SANDISK CHINA LIMITED，其母公司为西部数据；本次交易资金来源为自筹资金等。

希荻微：3 月 7 日，公司发布 2024 年股票期权激励计划草案，本激励计划拟授予的股票期权数量 1107.45 万份，占公告日股本总额的 2.70%。授予股票期权的行权价格为每份 14.38 元，为 3 月 8 日收盘价的 97%，首次授予的激励对象总人数为 144 人，占公司员工总数（截至 2023 年 12 月 31 日）288 人的 50%。业绩考核目标为，以 2023 年为基数，2024-2027 年营收增速分别不低于 10%/20%/30%/40%。

芯动联科：3 月 4 日，公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 31,708.68 万元，较 2022 年同比增长 39.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,539.88 万元，同比增长 41.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,285.31 万元。

■ 投资建议：

AI 依然是 2024 年最强赛道，重点关注 AI 产业链机遇：

- （1）核心算力标的：沪电股份、工业富联、寒武纪、海光信息、通富微电、兴森科技、香农芯创；
- （2）AI+：立讯精密、传音控股、华勤技术、力芯微

存储：赛道三重逻辑共振，AI 创新+涨价+国产化，建议关注相关标的：

- （1）弹性模组端：德明利、江波龙、佰维存储、朗科科技、万润科技等；
- （2）HBM 产业链：香农芯创、赛腾股份、精智达、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、深科技等；
- （3）DDR5 产业链：澜起科技、聚辰股份；
- （4）上游设计端：兆易创新、普冉股份、东芯股份、北京君正等；

国产化产业链机会：

- （1）设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、精测电子、中科飞测、华海清科、芯源微；
- （2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；

■ 风险提示：需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

内容目录

1.行情回顾：市场涨跌互现，半导体指数跌 1.05%	- 4 -
1.1 海内外市场表现	- 4 -
1.2 A 股细分板块表现	- 5 -
1.3 沪、深股通总体增持半导体板块	- 8 -
2.行业新闻：Claude 3 系列模型发布，海力士计划扩产存储封测	- 9 -
3.板块跟踪：关注 AI 受益板块和国产化主题.....	- 10 -
4.重要公告：长电科技收购闪存封测商.....	- 11 -
5.投资建议.....	- 12 -
6.风险提示.....	- 13 -

1.行情回顾：市场涨跌互现，半导体指数跌 1.05%

1.1 海内外市场表现

图表 1: 海内外市场表现 (2024/3/4-2024/3/8)

指数名称	本周涨跌幅
沪深 300	0.20%
上证综指	-0.35%
深证成指	-0.70%
创业板指数	-0.92%
中信电子	-0.17%
半导体指数	-1.05%
费城半导体	0.57%
台湾半导体	10.95%

来源: wind, 中泰证券研究所

图表 2: 费城半导体指数



来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 3 月 8 日

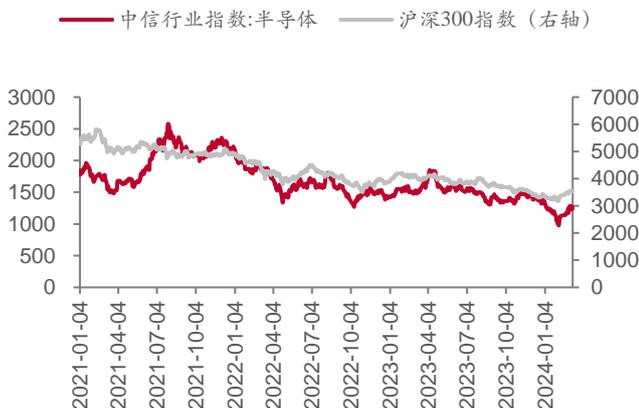
图表 3: 全球半导体月度销售额及增速



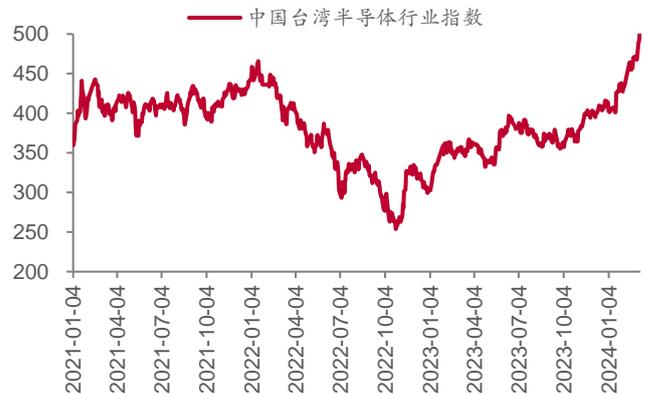
来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 3 月 8 日

图表 4: A 股半导体指数



图表 5: 中国台湾半导体指数

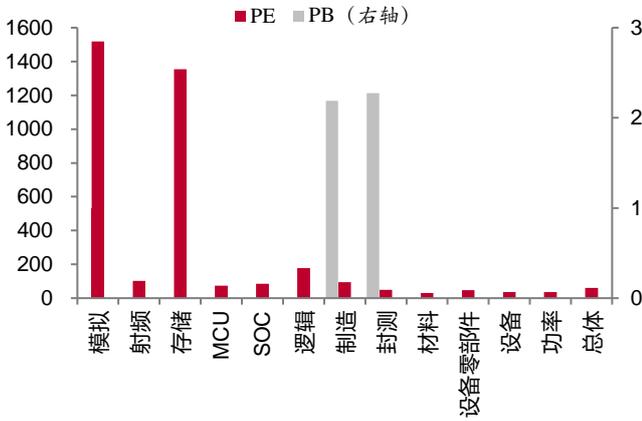


来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 3 月 8 日

1.2 A 股细分板块表现

图表 6: 细分板块估值情况 (2023E)



来源: wind, 中泰证券研究所

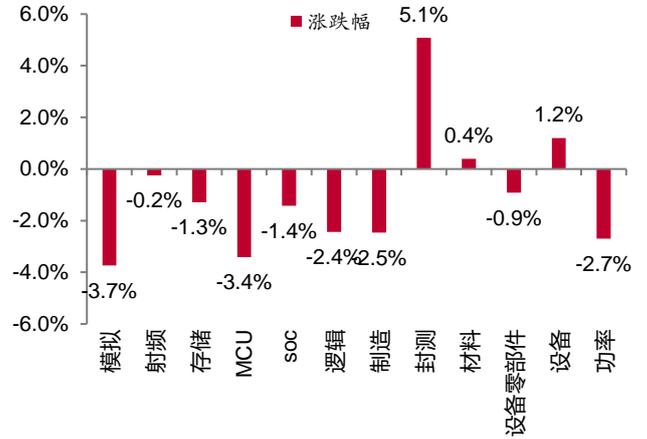
注: PE=最近市值、2023 年 wind 一致预期净利润

注: PB=最近市值、2023 年 wind 一致预期净资产

来源: wind, 中泰证券研究所

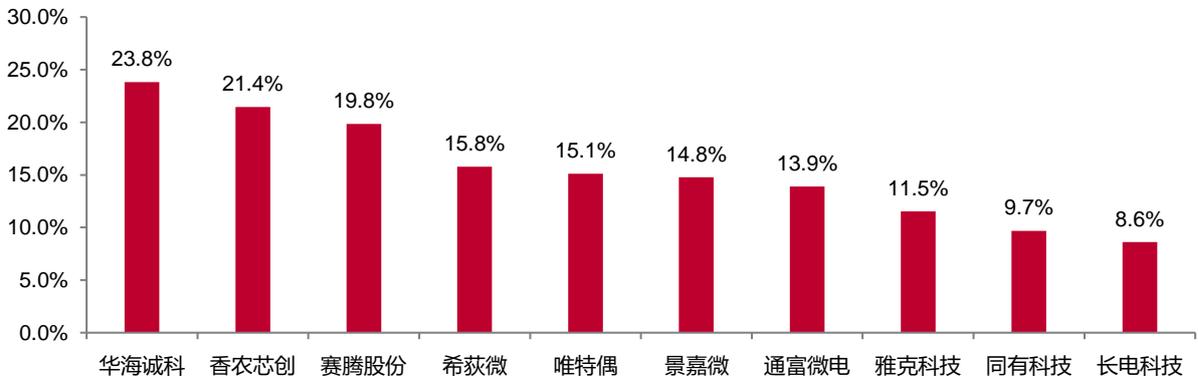
注: 截至 2024 年 3 月 8 日

图表 7: 本周半导体各细分板块涨跌幅情况



来源: wind, 中泰证券研究所

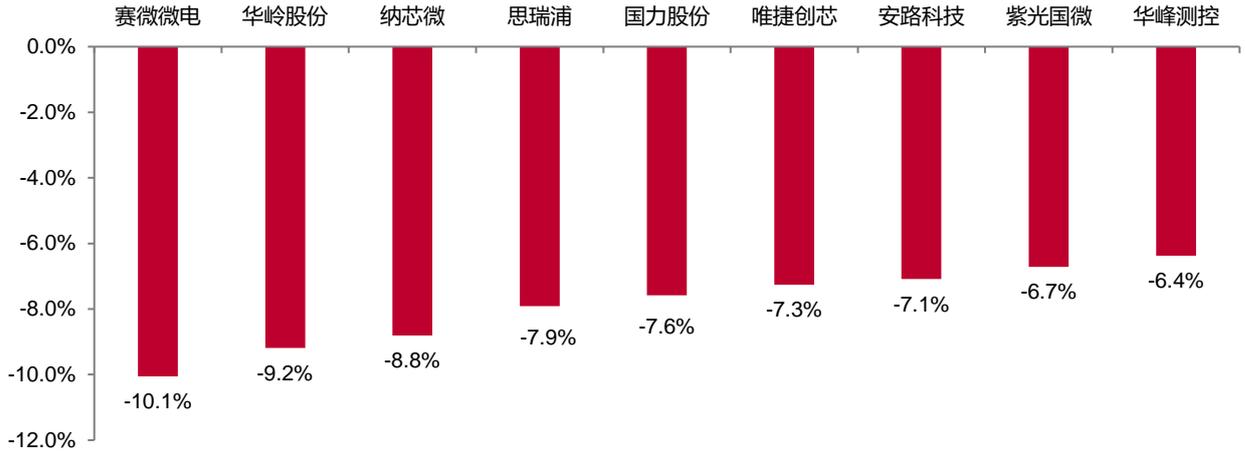
图表 8: 本周半导体行业涨跌幅前十公司



来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 3 月 8 日

图表 9: 本周半导体行业涨跌幅后十公司



来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 3 月 8 日

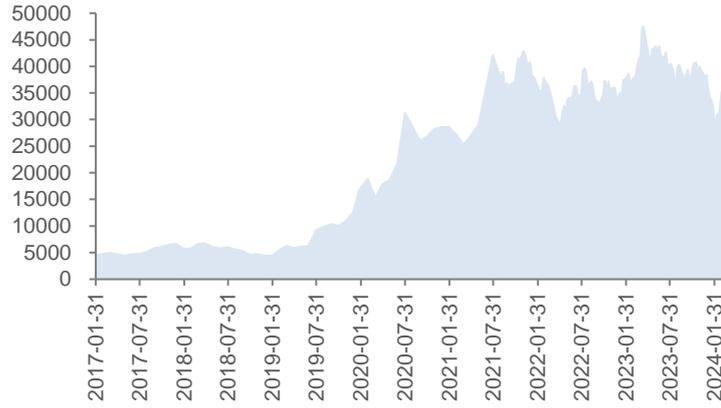
图表 10: A 股分板块公司总市值 (单位: 亿元)

板块	总市值	环比上周五涨跌幅
半导体	34910.2	-1.0%
模拟	2084.7	-3.7%
射频	882.1	-0.2%
存储	3074.2	-1.3%
MCU	760.1	-3.4%
SOC	1433.3	-1.4%
逻辑	5470.5	-2.4%
制造	5174.7	-2.5%
设备零部件	911.7	-0.9%
设备	5868.1	1.2%
材料	4036.0	0.4%
封测	2189.5	5.1%
功率	3025.4	-2.7%

来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 3 月 8 日

图表 11: A 股半导体板块公司总市值 (亿元)

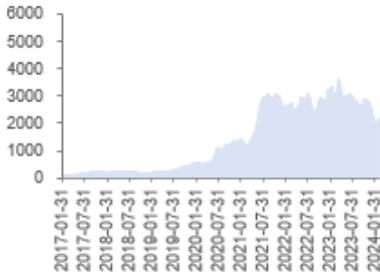


来源：wind, 中泰证券研究所

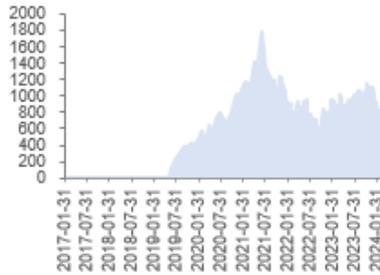
注：截至 2024 年 3 月 8 日

图表 12: A 股各细分板块公司总市值 (亿元)

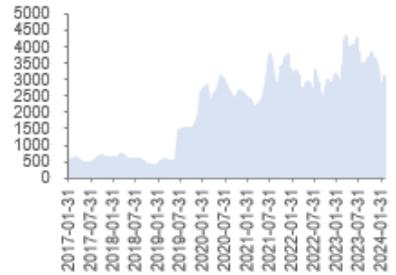
模拟板块

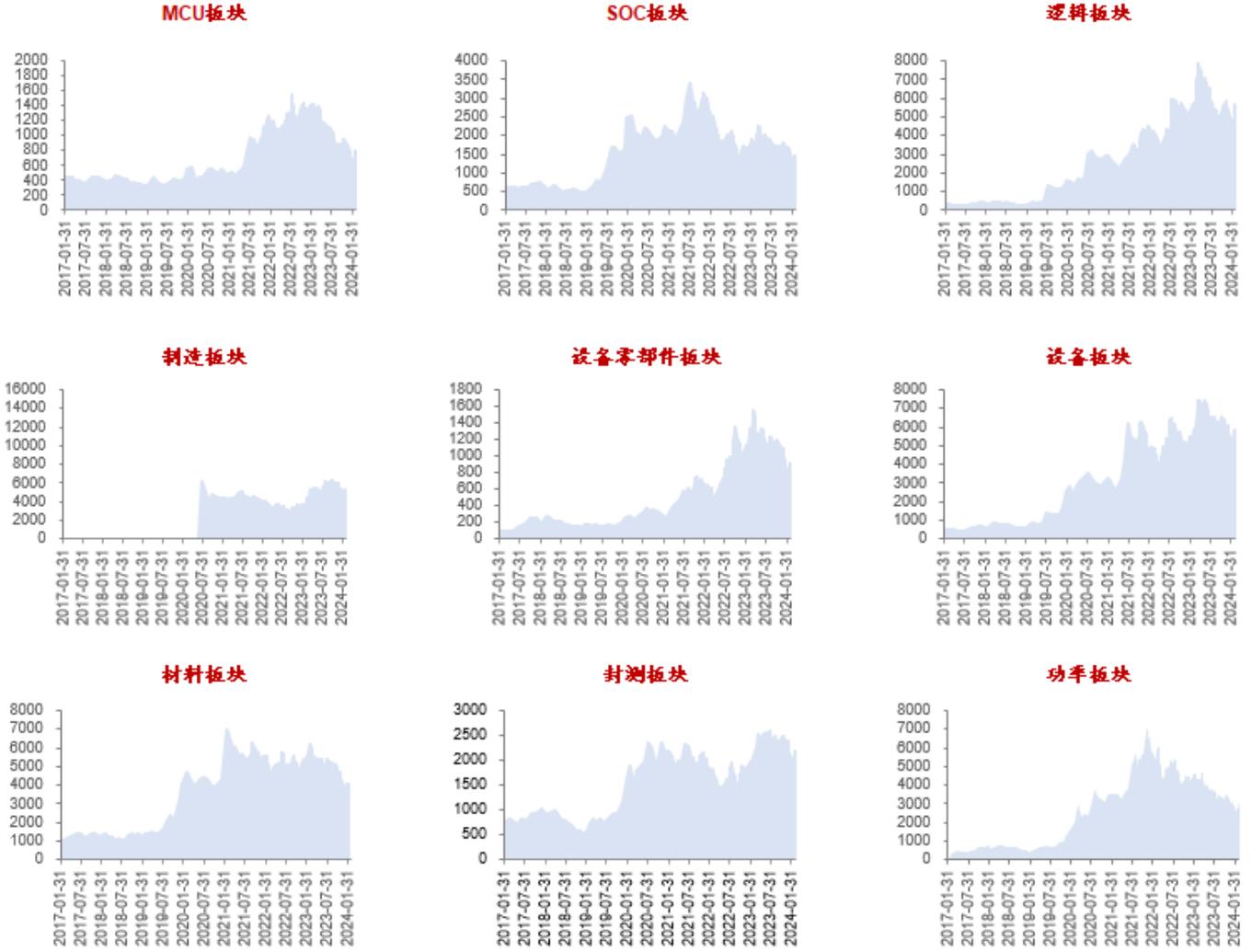


射頻板块



存储板块





来源：wind, 中泰证券研究所

注：截至 2024 年 3 月 8 日

1.3 沪、深股通总体增持半导体板块

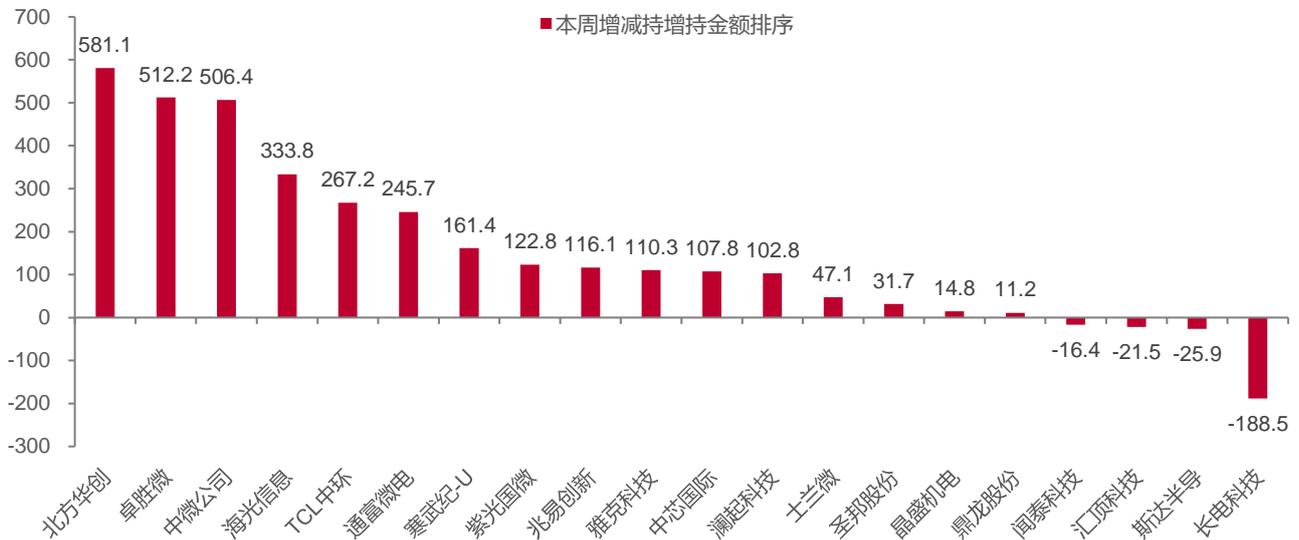
图表 13: 沪、深股通半导体板块持仓情况 (按持股市值排名)

本周排名	上周排名	证券代码	证券简称	一周增持金额 (百万元)	一月增持金额 (百万元)	年初至今增持金额 (百万元)	沪(深)股通持股市值 (百万元)	沪(深)股通持股占自由流通股比例%
1	1	002371.SZ	北方华创	581	2,004	2,366	8,916	11.3
2	2	688012.SH	中微公司	506	889	906	5,003	8.1
3	3	300782.SZ	卓胜微	512	473	293	4,497	12.4
4	4	300316.SZ	晶盛机电	15	-137	-576	3,418	15.7
5	5	688008.SH	澜起科技	103	273	488	3,228	6.9
6	6	600584.SH	长电科技	-189	-146	29	2,921	7.6
7	7	603986.SH	兆易创新	116	-139	976	2,819	6.3
8	9	688041.SH	海光信息	334	737	995	2,685	3.6
9	8	002129.SZ	TCL中环	267	191	-693	2,591	6.9
10	10	603160.SH	汇顶科技	-22	-41	215	1,940	11.9
11	11	600745.SH	闻泰科技	-16	5	153	1,691	5.0
12	12	002049.SZ	紫光国微	123	44	221	1,557	3.4
13	13	688256.SH	寒武纪-U	161	334	498	1,526	4.4
14	19	002156.SZ	通富微电	246	373	488	1,260	4.8
15	15	300661.SZ	圣邦股份	32	72	7	1,217	5.8
16	16	688981.SH	中芯国际	108	318	808	1,200	1.6
17	14	603290.SH	斯达半导	-26	111	150	1,175	10.1
18	18	002409.SZ	雅克科技	110	190	551	1,170	8.2
19	17	300054.SZ	鼎龙股份	11	29	13	998	7.2
20	20	600460.SH	士兰微	47	83	235	824	4.5

来源: wind, 中泰证券研究所

注: 此表中沪(深)股通持股市值=沪(深)股通持股数量*上周交易均价, 数据更新截止于 2024/3/8;

图表 14: 沪、深股通半导体板块本周增减持金额(市值前 20 公司)(单位: 百万元)



来源: wind, 中泰证券研究所

注: 截至 2024 年 3 月 8 日

2. 行业新闻: Claude 3 系列模型发布, 海力士计划扩产存储封测

■ Claude 3 系列模型发布, 全面超越 GPT-4

北京时间 3 月 4 日晚间, Anthropic 重磅发布其第三代 AI 大模型 —— Claude 3 系列模型, 包括 Claude 3 Opus、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Haiku。

- Opus (最智能): 系列模型最强版本, 在推理、数学、编码、多语言理解和视觉全方面评分超越 GPT-4, 树立了新的行业基准;
- Haiku (最速度): 目前是同类别中速度最快、性价比最高的模型, 支持三秒内读取一篇信息和数据密集的研究论文(约 10k token), 并附带图表和图形;
- Sonnet (最均衡): 在智能与速度之间找到了完美的平衡点, 特别适合承担企业级任务, 性价比高。

成本方面: Opus/Haiku/Sonnet 输入分别为 15/0.25/3 美金每百万 tokens, 输出分别为 75/1.25/15 美金每百万 tokens, 均支持上下文窗口 200K token; 相较于 GPT-4 输入/输出 30/60 美金每百万 tokens, 显著下降。

链接:

<https://mp.weixin.qq.com/s/rF75qhxpYxiC8DU8eg6fg>

■ 海力士计划扩大存储封测产能

据外媒报道, 为了巩固 HBM 存储芯片市场上的领先地位, SK 海力士 2024 年计划投资超过 10 亿美元, 扩大在韩国的测试和封装能力(主要是 MR-MUF 和 TSV 的投入)。业内人士预测, SK 海力士今年的资本支出总额将

达到 105 亿美元。

链接：<https://m.chinaflashmarket.com/news/industry/181403?app=article×t&=1709964331>

■ 马斯克：明年全球将从缺芯转为缺电

2月29日，在“博世互联世界2024”大会上，特斯拉CEO埃隆·马斯克远程接受了博世CEO斯特凡·哈同（Stefan Hartung）和董事长马库斯·海恩（Markus Heyn）的采访。马斯克在采访中提到，人工智能会碰到一些限制，例如芯片短缺，然后是供电问题。“接下来短缺的将是电力。我认为明年，你会看到，没有足够的电力来运行所有的芯片。”

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/fs1zlwT9UYNHWUr4MaS3ag>

■ 武汉新芯申请高带宽存储器在内的多个项目备案

据芯榜公众号，武汉新芯集成电路制造有限公司申请了三个项目备案，分别是应用于高带宽存储器的多晶圆三维集成技术研发及产业化、C2W混合键合技术研发和产线建设项目和高容值密度深沟槽电容制造工艺技术研发项目。

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/JjNG96DA3oh3cRMBaCkqZg>

3. 板块跟踪：关注 AI 受益板块和国产化主题

- **模拟**：本周模拟 IC 板块跌 3.7%。其中希荻微（+15.8%），公司下游主要为三星和国内重要安卓品牌为主的手机客户。模拟 IC 板块 2023 年经历周期调整后，主要公司基本上整体呈现边际向好态势，消费类下游复苏势头不减，泛工业下游有望逐步迎来复苏。同时模拟 IC 具备长周期成长属性，前期经历调整后，部分公司配置性价比逐渐显现，关注其中低估值标的和低国产化率的细分赛道。
- **存储**：本周存储板块涨跌幅-0.4%，个股存在分化，其中 HBM 产业链公司如香农芯创、赛腾股份（设备标的）、雅克科技（材料标的）涨跌幅+12%~+22%，HBM 随着 AI 需求市场规模爆发增长，持续供不应求状态，海力士等大厂加入投入。同有科技、恒烁股份、聚辰股份、德明利、东芯股份、普冉股份、佰维存储和深科技涨跌幅 0~+10%，江波龙、澜起科技、北京君正、兆易创新和朗科科技涨跌幅-5%~0。存储 AI 创新+涨价+国产化三重逻辑共振，另外 DDR5 渗透率确定性提升，持续看好存储板块。
- **功率**：本周功率板块跌 2.7%，扬杰科技（+0.6%）、台基股份（+0.4%）实现上涨，跌幅较大的公司主要有东微半导（-4.8%）、斯达半导（-4.6%）、华润微（-4.2%）。轨交电气装备公司大涨主要系“设备更新”有望带动公司轨交装备业务 24 年加速成长，扬杰科技 24Q1 二极管产品、海外业务有望出现边际复苏，业绩改善预期稳定股价。功率板块整体下跌，主要系市场担忧在光伏、新能源车需求增速边际减缓的情况下，叠加此前几年产能释出，行业出现供给过剩。
- **半导体设备**：本周半导体设备板块+1.2%，其中赛腾股份（+19.8%）、天准科技（+8.3%）、联动科技（+6%）、长川科技（+5.0%）涨幅居前。赛腾股份海外客户包括三星等 HBM 龙头厂商，市场看好其量测业务在

海外客户的放量。天准科技采用英伟达的 Jetson 边缘运算平台，构建了 AI 边缘计算控制器，有望受益于 AI 浪潮。联动科技正进行大规模数字集成电路测试系统架构的完善，未来有望实现数字测试机的研发面世。长川科技为综合型测试机平台企业，有望受益于国内高端测试机需求的增长。前道设备方面，北方华创涨 3.3%、中微公司涨 1.2%，其他主要前道设备公司股价出现不同程度回调，整体呈现涨势向龙头集中的现象。

- **半导体制造:** 本周芯片代工板块-2.5%，其中晶合集成 (-4.5%)、华虹公司 (-3.5%)、燕东微 (-2.9%) 跌幅居前。一季度为传统淡季，代工企业稼动率相对较低，相关公司股价走势较弱。
- **封测:** 本周半导体封测板块+5.1%，其中通富微电 (+13.9%)、长电科技 (+8.6%) 涨幅居前。板块上涨主要系先进封装主题催化，其中通富微电为国产先进封装布局较快的厂商，参与 AMD MI300 芯片封测；长电科技则于本周发布收购闪存封测商晟碟上海的公告，巩固自己存储封装实力。
- **材料:** 本周半导体材料板块+0.4%，其中华海诚科 (+23.82%)、唯特偶 (+15.11%)、雅克科技 (+11.52%) 涨幅靠前，本周板块涨幅靠前标的以 HBM/先进封装材料为主，主要系海力士计划加大 HBM 投资等因素催化。随着 AI 产业的加速发展，上游的先进封装材料国产化率极低，同时，包括光刻胶、掩膜版等在内的晶圆制造材料也是实现产业链自主可控的关键，随着产业链公司前期验证的产品逐步实现放量，基本面向好，相关公司具备持续成长动力，持续看好材料端的国产化主线。
- **逻辑:** 本周逻辑 IC 板块-2.4%，其中景嘉微 (+14.8%)、寒武纪-U (+0.7%) 涨幅靠前。AI 算力年后情绪火热，前期累计较大涨幅，本周海外 AI 算力链持续催化，戴尔业绩超预期、H2O 开始接受预订带动服务器公司大涨，国产芯片主要震荡为主。我们认为算力仍是人工智能产业最确定方向，未来央企加速发展 AI 也将推动国产算力替代加速，持续看好海外算力产业链创新及国产算力公司替代机遇。
- **SOC:** 本周 SoC 板块-1.4%，其中炬芯科技 (+0.8%)、博通集成 (-0.8%)、恒玄科技 (-0.9%) 涨幅靠前。本周板块整体震荡为主，SoC 历经两年调整，产品价格、渠道库存修复正常，需求逐步边际向好。目前板块处于底部区间，长期配置价值凸显，建议关注 Q1 业绩高增叠加新品创新周期方向。

4.重要公告：长电科技收购闪存封测商

- **希荻微:** 3月7日，公司发布 2024 年股票期权激励计划草案，本激励计划拟授予的股票期权数量 1107.45 万份，占公告日股本总额的 2.70%。授予股票期权的行权价格为每份 14.38 元，为 3 月 8 日收盘价的 97%，首次授予的激励对象总人数为 144 人，占公司员工总数（截至 2023 年 12 月 31 日）288 人的 50%。业绩考核目标为，以 2023 年为基数，2024-2027 年营收增速分别不低于 10%/20%/30%/40%。
- **芯动联科:** 3月4日，公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 31,708.68 万元，较 2022 年同比增长 39.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,539.88 万元，同比增长 41.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,285.31 万元。

- **长电科技:** 3月5日, 公司发布公告, 旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司 80%的股权, 收购对价约 6.24 亿美元。本次交易出售方为 SANDISK CHINA LIMITED, 其母公司为西部数据; 本次交易资金来源为自筹资金等。

5.投资建议

- **AI 依然是 2024 年最强赛道, 重点关注 AI 产业链机遇:**
 - (1) 核心算力标的: 沪电股份、寒武纪、海光信息、工业富联、通富微电、兴森科技、香农芯创;
 - (2) AI+: 立讯精密、传音控股、华勤技术、力芯微
- **存储: 赛道三重逻辑共振, AI 创新+涨价+国产化, 建议关注相关标的:**
 - (1) 弹性模组端: 德明利、江波龙、佰维存储、朗科科技、万润科技等;
 - (2) HBM 产业链: 香农芯创、赛腾股份、联瑞新材、华海诚科、雅克科技、深科技等;
 - (3) DDR5 产业链: 澜起科技、聚辰股份;
 - (4) 上游设计端: 兆易创新、普冉股份、东芯股份、北京君正等;
- **国产化产业链机会:**
 - (1) 设备: 北方华创、中微公司、拓荆科技、精测电子、中科飞测、华海清科、芯源微;
 - (2) 零部件: 福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材;

图表 17: 盈利预测与财务指标

代码	重点公司	现价	EPS				PE		
		2024/3/8	2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E	
603501.SH	韦尔股份	94	0.8	0.8	2.2	112	117	42	
603986.SH	兆易创新	72	3.1	0.8	1.9	23	92	37	
300327.SZ	中颖电子	19	0.9	0.5	0.7	20	38	25	
688595.SH	芯海科技	33	0.0	-1.0	0.2	1665	-33	199	
300661.SZ	圣邦股份	72	2.4	0.5	1.1	30	141	67	
688173.SH	希荻微	15	0.0	-0.1	0.1	-396	-114	110	
688536.SH	思瑞浦	106	2.2	-0.3	1.6	48	-404	66	
300782.SZ	卓胜微	111	2.0	2.2	3.0	55	51	37	
600460.SH	士兰微	21	0.7	0.0	0.4	28	-499	57	
300373.SZ	扬杰科技	41	2.1	1.6	2.1	20	25	20	
603290.SH	斯达半导	148	4.8	5.5	6.9	31	27	22	
688711.SH	宏微科技	32	0.6	0.8	1.5	56	42	21	
605358.SH	立昂微	23	1.0	0.5	0.8	23	51	28	
300666.SZ	江丰电子	47	1.0	0.9	1.5	47	54	32	
688126.SH	沪硅产业	15	0.1	0.1	0.1	127	222	117	
002436.SZ	兴森科技	14	0.3	0.2	0.3	46	92	57	
002409.SZ	雅克科技	56	1.1	1.4	2.1	51	40	27	

300054.SZ	鼎龙股份	21	0.4	0.3	0.5	50	73	44
688019.SH	安集科技	147	4.0	3.9	4.9	36	38	30
688268.SH	华特气体	50	1.7	1.4	2.1	29	36	23
688106.SH	金宏气体	20	0.5	0.7	0.9	42	30	23
002371.SZ	北方华创	302	4.5	7.2	10.0	68	42	30
688037.SH	芯源微	116	2.2	1.8	3.0	54	64	39
688200.SH	华峰测控	88	5.8	1.8	2.7	15	48	32
688012.SH	中微公司	149	1.9	2.9	3.2	78	52	46
688630.SH	芯碁微装	69	1.1	1.4	2.2	61	50	32
688981.SH	中芯国际	47	1.5	0.6	0.8	31	78	56
688347.SH	华虹公司	34	2.3	1.1	1.1	15	30	30
600584.SH	长电科技	29	1.8	0.9	1.5	16	34	19
603005.SH	晶方科技	19	0.3	0.3	0.5	54	65	39
002156.SZ	通富微电	26	0.3	0.1	0.6	79	206	44
000021.SZ	深科技	15	0.4	0.5	0.6	35	31	25
002185.SZ	华天科技	8	0.2	0.1	0.3	35	67	26
688385.SH	复旦微电	36	1.3	0.9	1.4	28	41	26
688107.SH	安路科技	30	0.1	-0.5	0.0	201	-61	-686
603893.SH	瑞芯微	54	0.7	0.4	0.9	76	139	58
688008.SH	澜起科技	52	1.1	0.4	1.2	46	133	44
688099.SH	晶晨股份	55	1.8	1.2	2.0	31	46	27
688256.SH	寒武纪-U	171.18	-3.1	-2.0	-1.3	-55	-85	-128
002463.SZ	沪电股份	32	0.7	0.8	1.1	44	40	30
001309.SZ	德明利	91	0.8	0.2	2.7	108	412	34
300475.SZ	香农芯创	42	0.7	0.8	1.0	56	53	43

来源: wind, 中泰证券研究所

注: 2023E 数据已发布快报/年报采用公告数据, 2024E 数据采用 Wind 一致预期

6.风险提示

- 需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

投资评级说明:

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注: 评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价 (或行业指数) 相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准; 新三板市场以三板成指 (针对协议转让标的) 或三板做市指数 (针对做市转让标的) 为基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为基准, 美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准 (另有说明的除外)。		

重要声明:

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。